

MT18FL

- ・ MicroThin は18 μ mのキャリア銅箔が付いている極薄銅箔です。
MicroThin is ultra thin foil with 18 μ m carrier foil.
- ・ 微細回路形成に有効で、L/S=20/20以下の回路形成が可能です。
Usable for fine pitch pattern L/S=20/20 or less formation.
- ・ MT18Exに比べ、粗化処理面の粗さが低く、より微細回路形成に適しています。
Lower profile compare with MT18Ex, more suitable for very fine pattern.

用途/Application

- ・ 半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package

構成/Composition



生産拠点/Production Site

- ・ 日本 / Japan

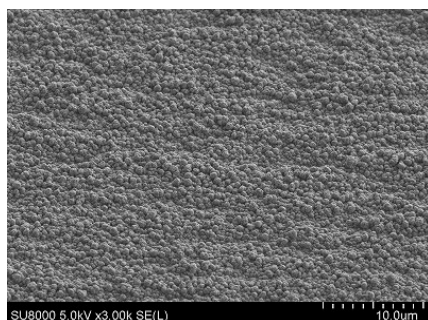
代表的特性値/Representive date

	μ m	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
MT18FL	1.5	18	1.3	—	—	1.2
	2	21	1.3	—	—	1.2
	3	30	1.3	—	—	1.2

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

※Peel Strength は、35 μ mまでメッキアップした後の測定値
Evaluated after plated up to 35 μ m

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

